



AGENDA

09:30	Registrierung	
10:00	Werksführung bei Digitaltest	
	<i>Raum 1</i>	<i>Raum 2</i>
10:30	Vergleich elektronischer Testverfahren	3D-MID Technologie
11:00	Prüfadapter und die Wichtigkeit guter Daten	Automatische Inspektionssysteme
11:30	Intelligente Softwareunterstützung	In-System-Programmierung
12:00	Ausstellung / Mittagspause am Burgerbus 	
	<i>Raum 1</i>	<i>Raum 2</i>
14:00	Vergleich elektronischer Testverfahren	3D-MID Technologie
14:30	Prüfadapter und die Wichtigkeit guter Daten	Automatische Inspektionssysteme
15:00	Intelligente Softwareunterstützung	In-System-Programmierung

ANMELDUNG

Die Teilnahme an unserem Technologietag ist für Sie kostenfrei. **Anmeldeschluss** ist der **10. April 2018**.

Das **Anmeldeformular** finden Sie online unter: technologietag.digitaltest.com

Offen Fragen beantworten wir gerne per E-Mail (marketing@digitaltest.com) oder telefonisch unter +49 (0) 7244 9640 59.

VERANSTALTUNGSORT

Digitaltest GmbH
Lorenzstraße 3
76297 Stutensee
Tel.: +49 (0) 7244 9640 0
www.digitaltest.com

Zur Anmeldung:



SHADES OF TEST



TECHNOLOGIETAG
17. April 2018

Verschiedene Testverfahren für Ihre speziellen Testanforderungen



Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Testleben?
Fehlt Ihnen vielleicht noch das gewisse Etwas?

Wir hätten da was für Sie: Einblicke in eine Testwelt, die Ihren Anforderung gerecht wird und keine Wünsche offen lässt. Interessiert? Dann melden Sie sich an zu unserem ersten **Technologietag**, am **17. April 2018** in Stutensee.

Shades of Test

Verschiedene Testverfahren für Ihre speziellen Testanforderungen

Lassen Sie sich fesseln, von unseren Vorträgen rund um die spannende Welt des Testens.

Wir führen Sie ein, in intelligentes Testhandling, zeigen Ihnen passende Testmethoden und wie Sie Flash für Ihre Produktion nutzen können. Wir entführen Sie in die Welt der automatischen Inspektionssysteme, scheuen nicht vor speziellen Datenanforderungen für den Adapterbau und zeigen was die Zukunft im Sinne hat mit 3D-Leiterplatten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Digitaltest-Team



UNSERE THEMEN

Herausforderungen und Potenziale der Technologie 3D-MID

Die Technologie dreidimensionaler mechatronisch integrierter Baugruppen hat enorme Potenziale sowohl im Bereich der Fertigung hinsichtlich einer rationalisierten Fertigungskette als auch im Einsatz durch die Möglichkeit räumlicher und funktionaler Integration. Gleichzeitig dürfen jedoch die dabei zu bewältigenden Herausforderungen nicht vernachlässigt werden.



Elektronische Testverfahren – die richtige Wahl für Ihre Anforderungen

Bei der elektronischen Überprüfung von Baugruppen kann die Wahl zwischen verschiedenen Testverfahren getroffen werden. Aber wie finden Sie die optimale Teststrategie für Ihre Anforderungen? Finden Sie heraus, welche Verfahren welche Vorteile bieten und wann es sinnvoll ist Testmethoden zu kombinieren.



Intelligente Softwareunterstützung von NPI bis Änderungsmanagement

Eine CAD/CAM-Software unterstützt Sie entlang der gesamten Fertigungskette elektronischer Baugruppen. Aber nicht nur das – sie kann auch das Änderungsmanagement deutlich erleichtern. Durch intelligente Datenkollaboration mit dem Adapterbau können hier Kosten und Zeit eingespart werden.



Automatische Inspektionssysteme – Big Data zur Qualitätsregelung

Inspektionssysteme finden Fehler – sie liefern aber auch viele Informationen über die Stabilität des Fertigungsprozesses und die Streuung der Materialeigenschaften. Wer seine SPI, AOI und AXI-Systeme richtig nutzt, der beseitigt Fehlerursachen systematisch anstatt immer nur nach Fehlern zu suchen.



Prüfadapter und die Wichtigkeit guter Daten

Die Bauteildichte von Baugruppen wird immer höher und die Gefahr Niederhalter nicht ideal zu platzieren steigt. Deshalb wird es immer wichtiger die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit von Grafikdaten genauer zu untersuchen. Erfahren Sie welche Arbeitsschritte für die Erstellung eines Adapters notwendig sind und was vollständige Daten ausmachen können.



In-System-Programmierung – der Flash für Ihre Produktion

Woher kommt die In-System-Programmierung (ISP) und wie sieht die Zukunft aus? Sind nur zwei der Fragen, die hier beantwortet werden. Zudem sprechen die Experten über die Vorteile der ISP im Vergleich zur Programmierung einzelner Bausteine und stellen Anwendungsbereiche sowie die neuesten Modelle und Technologien bei SMH (FR 2.0) vor.



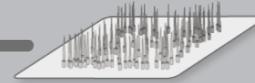
Neue Leiterplatten-Technologie



Automatische optische Inspektion (AOI)



Röntgen (AXI)



Adapterbau



In-Circuit Test / Flying Probe



Flash-Programmierung

